# **BUT 3 Mesures Physiques Parcours MCPC en alternance**



**DU TECHVIMAT** 



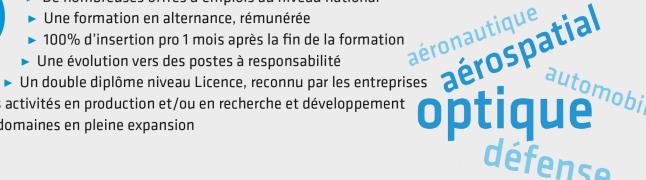
## EN 1 AN, UN DOUBLE DIPLÔME POUR DEVENIR **CADRE TECHNIQUE EN TECHNOLOGIE DU VIDE**

Les points forts d'une formation unique en France

100% **D'INSERTION PRO** 

- De nombreuses offres d'emplois au niveau national

- Des activités en production et/ou en recherche et développement
- Des domaines en pleine expansion



microélectronique

Un BUT 2/BTS/L2 dans les secteurs de la mesure (Mesures Physiques), des matériaux, de la physique, de la mécanique, de l'optique, de la productique, de l'électrotechnique, de la thermique, de l'énergie et de la maintenance...

Me forme aux technologies du vide ;

Maîtrise les installations de dépôts de couches minces (dépôts de matériaux d'épaisseur de l'ordre du nanomètre, micromètre) ;

Développe des technologies capables de donner aux objets des propriétés particulières et innovantes (antireflet, conversion d'énergie, résistance à l'usure, semi-conducteur...);

Suis capable de caractériser et de réaliser des mesures sur les matériaux déposés :

Fais preuve de polyvalence.

i'ai

Avec le double diplôme **BUT MP et DU TECHVIMAT.** ie

## **TECHVIMAT**



### **Débouchés & Métiers**



Les entreprises > AIRBUS, AIR LIQUIDE, ALLIANCE CONCEPT, CEA, CILAS, ESSILOR, HEF, LYNRED, PFEIFFER VACUUM, SAFRAN, SOITEC, STMicroelectronics, THALES, THERMI-LYON,...

Les métiers > Assistant-ingénieur ultravide, Technicien dépôts couches minces, Contrôleur salle blanche, Technicien maintenance vide, Ingénieur des ventes...



## Exemples de missions d'alternance

Marie- Clotilde	IREIS/HEF	J'ai participé à des projets de recherche et développement en effectuant des dépôts de couches minces sous vide.
Renaud	THALÈS	Ma mission consiste à mettre en place des mesures de vide primaire à l'intérieur d'un satellite.
Emmanuel	AIR LIQUIDE (CERN)	J'effectue des tests de recherche de fuites sur composants liés aux accélérateurs du CERN.
Margaux	ESSILOR	J'ai contribué à l'amélioration des caractéristiques de couches antireflets sur des verres de lunettes.



## Programme

<b>Grands Domaines</b>	Quelques Matières
FORMATION SCIENTIFIQUE	Plasmas, matériaux, physique, mathématiques
COMMUNICATION, ENTREPRISE	Anglais, expression-communication, droit du travail
TECHNOLOGIE DU VIDE	Réalisation de dépôts sous vide, technologie de pompage, contrôle et mesures sous vide
TRAITEMENTS DE SURFACES	Caractérisation de dépôts sous vide, procédés industriels, méthodes de caractérisation
➤ Parcours Surfaces	Etudes de cas (caractérisation de couches), physico-chimie des matériaux
► Parcours Conception	Conception de matériel de vide, équipement sous vide

#### Moyens pédagogiques et/ou techniques innovantes :

- ▶ Plateforme technologique interne à l'IUT (matériaux et dépôts de couches minces)
- Équipement technique de pointe
- ► TOEIC compris dans la formation

#### RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES, INSCRIPTIONS

Département MP : iutmph@univ-st-etienne.fr : 04.77.46.34.51

**Service Formations et Entreprises**; iutse-formation@univ-st-etienne.fr; 04.77.46.33.21 28, avenue Léon Jouhaux CS 92320 42023 Saint-Etienne

www.iut.univ-st-etienne.fr



#### Comment postuler:

Candidature via E-Candidat : www.iut.univ-st-etienne.fr Pré-sélection sur dossier, puis entretien d'admissibilité, nombre de places limitées

#### Validation du diplôme :

Contrôle continu (IUT et entreprise) et rapport d'alternance + soutenance

#### Équipe pédagogique :

Enseignants de l'IUT et intervenants professionnels (55% d'intervenants pro)

#### Rythme d'alternance:

5 sessions de 3 semaines à l'IUT

#### Comment bénéficier de la formation :

- ► Contrat d'apprentissage
- ► Congé de formation, ProA
- ► Demandeurs d'emploi
- ► Possibilité de Validation des Acquis de l'Expérience

#### Coût de la formation :

- ► Formation gratuite pour les apprentis
- ► Employeurs : financement OPCO selon tarifs France Compétences

#### Accessibilité :

Pour toute personne en situation de handicap, merci de nous contacter : iutse-formation@univ-st-etienne.fr



